

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司
2026 年半年度业绩说明会活动记录

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
时间	2026 年 9 月 10 日
地点	同顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir
上市公司 参会人员	魏镇炎（总经理）、史金鹏（董事会秘书）、吴新宇（财务长）、张莉（独立董事）、黄江东（独立董事）
业绩说明会 Q&A 记录	【问题】 公司减持情况如何？ 【回答】 大股东尚未开始减持，本次减持是以大宗交易减持的，大宗交易的受让方于受让之日起六个月内不得转让其受让的股份。在实施本次减持计划期间，公司将督促减持主体严格按照相关减持规定实施减持计划，同时公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。 【问题】 环旭电子前几天发布的 cpo/npo 运用中的核心组件 ELSFP 在同行业处于什么水平？ 【回答】公司本次发布的 ELSFP 系列产品遵循 OIF-ELSFP-02.0 协议，集成双 12 芯 MT 插芯连接器，插损低于 0.3dB；各个通道采用低弯曲损耗保偏光纤，偏振消光比 PER>20dB。特别地，公司结合自身工艺设计自主开发了透镜与光纤阵列单元（FAU）自动耦合固化设备。该耦合固化设备实现了光耦合重复性误差<3%、通道间偏差<3%、固化后变动误差<5%。自制 Lens 及 FA 耦合设备完美匹配产品结构 with 光路设计，显著提升了耦合效率与量产一致性，chiptofiber 批量生产耦合效率均可达 85%以上。

	〔问题〕 今年下半年业绩怎么样？ 〔回答〕通常下半年为公司的业务旺季，总体经营表现会强于上半年。第三季度受部分业务关键物料采购价格涨幅较大影响，公司预计第三季度单季营业收入同比增长 15%-20%，第三季度单季营业利润率环比增长 0.5 个百分点左右。 〔问题〕 贵司控股子公司成都光创联有没有自研光器件和光引擎？ 〔回答〕 成都光创联业务主要包括数据中心、高速电信和工业光电三大产品线。其中，数据中心产品主要包括 400G/800G/1.6T 单模硅光引擎、DCI lite & DCI (Data Center Interconnect) 产品、ELSFP 光源产品；高速电信产品主要包括光传输网产品、固网接入产品、无线前传产品；工业光电产品主要包括 Narrow Linewidth Laser (NLL) /Tunable NLL 激光器光源及模组、多芯片 RGB 集成 MCL 激光光源模组。 〔问题〕 你好，AI 全球产业订单暴增；公司 AI 服务器板卡产能放量能否跟的上？ 〔回答〕 针对服务器板卡业务，受益于客户的需求持续提升，公司持续在产能扩充、智能制造和配合客户需求的生产据点布局上增加投资。产能规划方面，AI 智能卡于 2026 年上半年扩充至 180K 的月产能，公司已规划再增加两条产线，年末达成 225K 的月产能目标，于 2027 年上半年达成 270K 的月产能目标，这将构成支撑智能卡业务持续快速成长的基础。 〔问题〕 公司 PDU 业务此前是匹配 TSMC SOW 制程所开发的，该制程目前量产时间有所延期，那公司是否有进一步在这个业务上匹配目前客户所需的制程并新的客户？公司是否有相应的人员技术储备？ 〔回答〕 目前公司已与 ASE 以及功率芯片的合作伙伴共同开发 PDU lite 产品，以适配客户目前的需求，在今年三季度会首次送样，并计划于 2027 年下半年开始小批量，2028 年有望进行规模化量产。目前已规划的 NPI 产线及配套 capex 预估在 1,300 万美元左右。从人员储备上，公司针对该业务领域，持续招聘技术人员，以满足业务开展的需求。 〔问题〕 CPO 的业务领域上，公司与 ASE 协同并于海外客户沟通时，公司的具体业务定位是什么？
--	---

	【回答】 光创联加入环旭电子后，得到了整个集团在业务上的支持。在 CPO 的项目上，我们与客户接洽中，客户对公司的需求主要集中在 D-FAU 的耦合以及 ELSFP 上，这两部分业务是公司未来推进的重点业务。 CPO 的制程上，ASE 会聚焦前端的先进封装，公司将聚焦后端的光学工艺设计及测试。在 CPO 量产角度上来看，FAU 的多通道耦合是一个重大挑战，会带来良率的损失，此前公司业务已经涉足多通道耦合，在 32 通道（16 收 16 发）形成出货，已经有了一定的技术积累，在这方面公司目前也在形成专利技术并着手申请中。D-FAU 的多通道耦合在行业内还是具有较高挑战性的，如果能较好的解决耦合工艺制程及良率等问题，相信公司能够在这方面形成较强的竞争优势。 此外，在 D-FAU 的耦合上，公司还积累了自研耦合设备的能力，结合公司的工艺制成和算法开发自动化的耦合设备，相较于行业内其他厂商，这将是公司特有的竞争优势。 【问题】 公司 D-FAU 和 ELSFP 的业务进展如何？ 【回答】 D-FAU 的耦合及 ELSFP 将作为公司在 NPO/CPO 应用中的重点产品，成都研发中心进行开发，NPI 及量产会按照客户对应区域及要求，成都及越南分别负责国内及海外客户。D-FAU，将已封测 chiplet 搭建光学 fan-out 方案，解决定制化的 connector 的 active alignment 和 attachment，完成最终 optical engine 的测试与出货。ELSFP：产品已进入设计验证阶段后期，方案可兼容多家芯片资源，光学耦合效率以及散热管理等关键参数已完成进一步的优化。在 D-FAU 和 ELSFP 上，公司已与多家头部客户开展合作，预估 NPO 市场放量将早于 CPO，公司有望在 2027H2 进入 ELSFP 的小批量或批量生产，成都暂定的一期产能规划为 100K/M，后面会视项目进展情况进一步扩展调整。同步，公司已启动越南新工厂建设，预估于 2028H1 具备量产能力。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 10 日